

特許協力条約

PCT

国際予備審査報告

REC'D **2 0 JUN 2003**WIPO PCT

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の書類記号 150200052971	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。							
国際出願番号 PCT/JP02/09975	国際出願日 (日.月.年) 26.09.02 優先日 (日.月.年)							
国際特許分類 (IPC) Int.C1' H01L21/56, H01L23/12								
出願人 (氏名又は名称) 株式会社 日立製作所								
1. 国際予備審査機関が作成したこの	国際予備審査報告を法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送	付する。						
2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で ページからなる。								
この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。 (PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照) この附属書類は、全部で ページである。								
3. この国際予備審査報告は、次の内容	容を含む。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•						
I X 国際予備審査報告の基礎								
Ⅱ □ 優先権								
III	上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成							
IV 開の単一性の欠如								
V 区 PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明 Ⅵ □ ある種の引用文献								
VII 国際出願の不備								
VII 国際出願に対する意見	-	ļ						
•								
	·							
国際予備審査の請求 各受理した日 26.09.02	国際予備審査報告を作成した日 03.06.03							
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP 郵便番号100-8915 東京都千代田区般が関三丁目4	中澤登 印	6365						



国際出願番号 PCT/JP02/09975

I. [国際予備審査報	告の基礎	<u> </u>			
1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。 (法第6条 (PCT14条) の規定に基づく命令に 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。 PCT規則70.16,70.17)						
X	出願時の国際	出題書類				
	明細書 明細書	第 第 第	_ ページ、 _ ページ、 _ ページ、 _ ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 		
	請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲	第 第 第 第	項、 項、 項、 項、	出願時に提出されたもの PCT19条の規定に基づき補正されたもの 国際予備審査の請求ቔと共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの		
	図面 図面 図面	第 第 	ページ/図、 ページ/図、 ページ/図、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 一一一一付の書簡と共に提出されたもの		
	明細書の配列	刑表の部分 第 刑表の部分 第 刑表の部分 第	ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求啓と共に提出されたもの 		
2.	上記の出願書	質の言語は、下記に示す場合	を除くほか、こ	の国際出願の言語である。		
上記の書類は、下記の言語である 語である。 □ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語 □ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語 □ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語						
3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。 □ この国際出願に含まれる書面による配列表 □ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表 □ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった □ 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。						
4.	補正により、] 明細書] 請求の範囲] 図面	下記の 書類が削除された。 第 第 図面の第	項	· -ジ / 図		
5. □ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1.における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)						
	,					



国際出願番号 PCT/JP0'2/09975

V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能 文献及び説明	性についての法第12条 (PCT35条(2)) に定める見解、それを裏	付ける
1. 見解		
新規性 (N)	請求の範囲 6-13, 16 請求の範囲 1-5, 14, 15	有 無
進歩性(IS)	請求の範囲 1-16	有 無
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲 <u>1-16</u> 請求の範囲	有 無
2. 文献及び説明 (PCT規則70.7) 国際調査報告で引用された		*
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(株式会社三井ハイテック), 2002. 01. 11 A(松下電器産業株式会社), 2000. 05. 30	
1. 請求の範囲1-5に係本発明は、文献1の第1~ り、新規性、進歩性共に有し 9」のいわゆるアンダーフィ 導体チップの樹脂封止である 脂で半導体全体を封止するこ	4図と【0014】~【0021】欄に記載されて ない。なお、文献1に示された発明は「半導体チッ ルに関する発明であるが、アンダーフィルであって ことにかわりはなく、また、アンダーフィルに用い	お プ 1 も 樹
2. 請求の範囲 6, 7に係 トランスファーモールディ て、その適用は当業者にとっ い。	る発明について ング法もポッティング法も通常の樹脂封止方法であ て容易になし得ることであり、本発明は進歩性を有	っ しな
書に記載する必要のない程度	明について の記載を見いだせないから、当該工程の作用効果は の自明なものと推定され、その程度の工程であれば とであり、本発明は進歩性を有しない。	明細当業

4. 請求の範囲9-13に係る発明について

文献1の第1~4図と【0014】~【0021】欄 及び 文献2の第5~7図と【0004】~【0013】欄を参照。 文献2の上記箇所には、LOC型半導体装置が示されており、当該装置の製造において文献1に示された製造方法を適用することは当業者にとって容易になし得ることであり、本発明は進歩性を有しない。



国際出願番号 PCT/JP02/09975

補充欄(いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

第 V 欄の続き

5. 請求の範囲14, 15に係る発明について 文献1に示された製造方法においてもベーク処理の後で検査されており、その後に 装置を半田付けすることは文献1に示された発明においても当然に予定されているも のであり、本発明は新規性、進歩性共に有しない。

6. 請求の範囲16に係る発明について 文献1に示された製造方法によって製造された電子装置をPbフリー半田によって 実装することは、Pbフリー半田が周知技術であることから当業者にとって容易にな し得ることであり、本発明は進歩性を有しない。